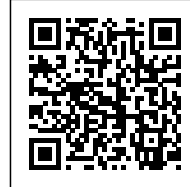


**DISPENSING EQUIPMENT
DIRECT DISPENSING UNIT**

Artikelnummer: S3-0006
16.200,00 € exkl. MwSt.



Kategorien: [Dosiersysteme](#), [Module](#)

BESCHREIBUNG

Die Direct Dispensing Unit stellt Dispensmaterial mit einer definierten Schichtdicke und Verteilung bereit. Dabei kann zwischen den Technologien „Direkt Dispensen“ und „Pin-Transfer“ gewählt werden.

Die Einheit wurde entwickelt, um eine homogene Schicht eines Mediums auf die Unterseite der zu bestückenden mikroelektronischen Bauelemente im Prozess bereitzustellen. Das Bauteil ist beim Direktdispensen gleichzeitig das Stempelwerkzeug. Damit wird der Kleber immer an der Bauteil-Unterseite appliziert, womit sich auch engste Platzierungen realisieren lassen.

Beim Pin-Transfer-Verfahren übertragen prozessspezifisch gefertigte Stempelwerkzeuge das gewünschte Muster. Wie auch beim tropfenförmigen Nadel- oder Jetdosieren appliziert die Direct Dispensing Unit eine homogene und reproduzierbare Klebstoffschicht. Dadurch wird verhindert, dass angrenzende Bereiche von Bauteilen oder Substraten unbeabsichtigt mit Klebstoffen benetzt werden.

Die Struktur der Vakuumrunde sowie die Form der Dispensspur werden über die prozessspezifische Rakelplatte definiert.

Dank der modularen Bauweise der Direct Dispensing Unit, lässt sich die Station vom Anwender in die relevanten Einzelteile zerlegen und vereinfacht damit die Wartung und Reinigung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|--|--|
| Abmessungen in mm (B x T x H) | 145 x 108 x 127 |
| Gewicht in kg | 2,4 |
| Dispensspurhöhe | Skalierte Höhenverstellung des Trägersystems der Rakelplatte |
| Einstellbereich in mm | 0 ... 4 |
| Verstellgenauigkeit in μm | 5 |
| Spannung in V | 24 |
| Max. Stromstärke in A | 0,5 |
| Kommunikationsschnittstelle | UNICAN |
| Funktionstemperaturbereich in $^{\circ}\text{C}$ | 20 ... 35 |

